



Standard-Lagenaufbau-Multilayer für Leiterplatten im Pool

4-Lagen Aufbau

4-layer: type1		Thickness μ
	Cu foil	18
	Prepreg 2125	100
	Prepreg 7628	200
	Prepreg 7628	200
	Core 35/35	35 550 35
	Prepreg 7628	200
	Prepreg 7628	200
	Prepreg 2125	100
	Cu foil	18

6-Lagen Aufbau

6-layer: type 2		Thickness $\hat{\mu}$
	Cu foil	18
	Prepreg 2125	100
	Prepreg 2125	100
	Core 35/35	35 350 35
	Prepreg 2125	100
	Prepreg 2125	100
	Core 35/35	35 350 35
	Prepreg 2125	100
	Prepreg 2125	100
	Cu foil	18
		1476 $\hat{\mu}$

Innerhalb unseres Non-Pooling-Services On demand können Kunden ihren Leiterplatten-Aufbau individuell gestalten, wobei Kombinationen von FR4 und Rogers Material möglich sind. Wenn die Stärke des Dielektrikums für die Impedanzkontrolle von Bedeutung ist, sollte das entsprechende Dielektrikum mit einer Zahlenangabe genau spezifiziert werden. Dies ist notwendig, da die endgültige Dicke der Prepreg-Lagen von den Kupferlagen oben und unten abhängig ist.

Geben Sie bitte auch bei einem ungefähren Leiterplatten-Aufbau um die Mittelachse der Platine sowohl das Material als auch die Stärke der Kupferfolie an. Bitte achten Sie auf einen symmetrischen Aufbau der Signal- und Potenzial-Lagen.

Maximale Größe einer Leiterplatte

Pooling: 425 x 425

Non-Pooling: größere Leiterplatten sind möglich; bitte kontaktieren Sie anfrage@electronicprint.eu.

Abweichende Kupfer- und Platinen-Stärke bei fertigen Leiterplatten

Die Abweichungen der Platinen-Stärke können +/- 10%, maximal 0,18 mm betragen.

Um die allgemeine Dicke einer Leiterplatte zu berechnen, messen Sie bitte die Stärke der Kupferfolie in einem kupferfreien Bereich. Ziehen Sie davon die Dicke des Lötstopplacks, falls vorhanden, ab. Dann addieren Sie dazu die Kupferstärke. Bei einer ein-lagigen Platine ist dies die Dicke der Kupferfolie.

Bei einer zwei-lagigen Leiterplatte ist die Kupferstärke der Außenlage die Summe der Kupferfolie und der Metallisierungsstärke. Die Dicke der Metallisierungsschicht variiert von 30 – 50 Mikron und hängt von der Dichte und der Kupferstruktur ab.

Bei einem Multilayer ist die Kupferstärke der Innenlage die Dicke der benötigten Kupferfolie.

Bitte beachten Sie, dass die minimalen LB-Breiten und Isolierabstände sowie die minimalen Restringe der Platinen von der benötigten Kupferfolie abhängen. Je dicker die Basisfolie ist, desto schwieriger ist es, feine Strukturen zu ätzen. Sie finden die minimalen Werte, die wir entsprechend der Kupferstärke produzieren können.